

15-Tonnen Automatische Vakuum-Heißpresse Mit 200X200Mm Heizplatten Und Wasserkühlung

Artikelnummer: XP33



Einführung

Entdecken Sie KINTEKs automatische 15-Tonnen-Vakuum-Heißpresse: 200x200mm Heizplatten (bis zu 500 °C), präzise PID-Regelung, Wasserkühlung und SUS-304-Kammer für Vakuum- oder Inertgasverarbeitung – perfekt für Beutelzellen, Polymerlaminiierung und Diffusionsbonding.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Laminierung von Batterie-Beutelzellen	Die Laminierung von Beutelzellen für Lithium-Ionen- oder Festkörperbatterien erfordert gleichmäßigen Druck und Wärme, um Schichten zu verbinden, ohne den Elektrolyten zu beschädigen. Die Vakuumfunktion entfernt Feuchtigkeit und Gase, verhindert Delaminierung und erhöht die Lebensdauer der Zelle.	Verhindert Delaminierung, verbessert die Ionenleitfähigkeit und verlängert die Lebensdauer der Zyklen.
Polymerfolien-Laminierung	Laminieren von Polymerfolien oder Verbundfolien für die Elektronikapselung, medizinische Verpackung oder flexible Displays unter kontrollierter Temperatur und Druck.	Erzeugt blasenfreie, hochklare Verbindungen mit präziser Dickenkontrolle.
Diffusionsbonding	Fügen von Metallen, Legierungen oder Keramiken bei erhöhten Temperaturen unter hohem Vakuum ohne Schmelzen, wodurch atomare Diffusionsbindungen entstehen.	Erreicht hochfeste, porenfreie Grenzflächen, ideal für Wärmetauscher und mikrofluidische Geräte.
Pulververdichtung und Sintern	Verdichten von Metall- oder Keramikpulvern in einer Matrize unter Vakuum und Wärme, um dichte Pellets oder Vorformen zu bilden.	Erhöht die Dichte, verringert die Porosität und verbessert mechanische und elektrische Eigenschaften.
Aushärten von Verbundwerkstoffen	Aushärten von fortschrittlichen faserverstärkten Verbundwerkstoffen mit präzisen Druck- und Temperaturprofilen in einer Inertgasatmosphäre.	Optimiert die Vernetzung, verhindert Oxidation und sorgt für blasenfreie Laminat.
Montage flexibler Elektronik	Laminieren und Kapseln von flexiblen Schaltkreisen, OLED-Displays oder Dünnschichtsensoren mit wärmeaktivierten Klebstoffen unter Vakuum.	Erhält die Ausrichtung, beseitigt Ausgasungsfehler und schützt empfindliche Komponenten.

Spezifikation	Wert / Details
Modell	XP33
Max. Arbeitsdruck	≤ 15 Tonnen (150 kN)
Platten-Arbeitstemperatur	Raumtemperatur – 500 °C, programmierbarer PID-Touchscreen
Heizleistung	3000 W
Plattenabmessungen	200 mm × 200 mm
Plattenöffnung (Daylight)	50 mm
Vakuumpumpe enthalten	Drehschieber-Vakuumpumpe (Standard)
Vakuumniveau (Relativ)	< -0,1 MPa
Kammermaterial	SUS 304 Edelstahl

Spezifikation	Wert / Details
Atmosphärische Gasverträglichkeit	Stickstoff (N ₂) / Argon (Ar)
Kühlmethode	Zirkulierende Wasserkühlung (beide Platten)
Externe Abmessungen	650 × 492 × 725 mm
Nettogewicht	235 kg
Stromversorgung	AC 220V / 50Hz, Einphasig